

有鉛無洗浄ソルダペースト

SE/SSシリーズ



- 高精度に分級された球形はんだ粉末を使用
- 作業性、はんだ付け性、残渣信頼性に優れる
- 高密度表面実装に対応

■ 製品番号の表示方法



■ 粉末粒度表示記号

表示記号	48	58
粒度	20~45 μ m	20~38 μ m

■ はんだ合金の表示記号と組成

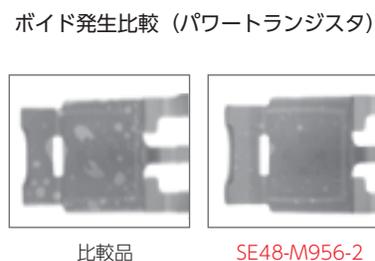
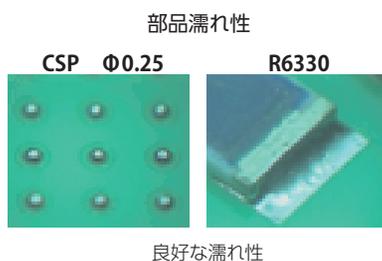
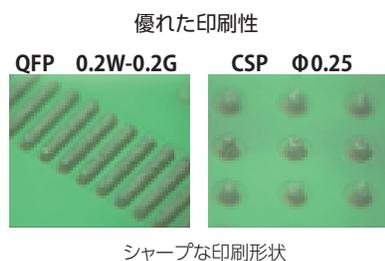
表示記号	一般名称	合金組成	融点 (°C)
SE	一般共晶	Sn 37Pb	183
SS	2Ag入り	Sn 36Pb 2.0Ag	179-190
SS-ES	0.5Ag入り	Sn 36.5Pb 0.5Ag	179-183

各種製品特徴

- SE48-M956-2** ファインピッチ (0.4mmピッチ・0.25mm ϕ)仕様で長時間連続印刷・断続印刷対応
SE48-A254 洗浄対応品。代替フロン・準水系洗浄剤での洗浄が可能
SS48-M955LV 超低ボイドタイプ。BGA・パワートランジスタなどあらゆる部品でのボイドを抑制
SS48-M955ES Sn/Pbに0.5%Agを添加したチップ立ち防止対策品

性能データ

■ SE48-M956-2の各種特性



製品物性表

製品名	SE48-M956-2	SE48-A254	SS48-M955LV	SS48-M955ES
合金組成 (%)	Sn 37Pb	Sn 37Pb	Sn 36Pb 2.0Ag	Sn 36.5Pb 0.5Ag
融点(°C)	183	183	179-190	179-183
粉末粒度(μ m)	20-45	20-45	20-45	20-45
粘度 (Pa·s)	200	180	190	200
フラックス含有量 (%)	10.0	9.5	9.3	10.0
ハライド含有量 (%)	0.0	0.14	0.0	0.0
フラックスタイプ	ROLO	ROL1	ROLO	ROLO
その他はんだ粒径	20-38 μ m (製品名:SE58-M956-2)	20-38 μ m (製品名:SE58-A254)	20-38 μ m (製品名:SS58-M955LV)	20-38 μ m (製品名:SS58-M955ES)